



【大阪】新規低伝送損失基板材料の要素技術開発及び新商品開発

パナソニックインダストリー株式会社での募集です。電子デバイス研究開発のご経験...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

パナソニックインダストリー株式会社

求人ID

1468294

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

大阪府

給与

500万円～850万円

勤務時間

08:30～17:00

休日・休暇

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 年次有給休暇（年間25日付与、初年度のみ入社月に応じ付与。2021年度平均取得日...

更新日

2024年05月25日 00:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2162375】

●担当業務と役割

当事業部が保有しているコア技術は、熱硬化性樹脂の材料設計技術です。

近年、5G/6Gと信号の高速化がますます進展しており、それに適用するため熱硬化性低損失基板の市場が拡大しています。

将来、この事業領域をさらに拡大するためには、樹脂に加えて、無機充填剤/基材/金属箔等の幅広い知識、経験を持った技術者を必要としています。

未来の配線板に適応される新しい材料の開発に加えて、顧客と一緒に新しい市場を切り開いて頂きたいと考えています。

●具体的な仕事内容

- ・新規絶縁材料の要素技術開発、商品開発、プロセス技術開発、評価技術開発
 - ・海外を含む顧客対応、顧客ニーズ調査、技術マーケティング活動
-

スキル・資格

[経験] ・硬化性樹脂を用いた材料開発および材料設計の経験 [知識] ・化学反応等に関する有機化学の知識 ・一般化学（有機、無機）に関する知識 ・一般化学分析に関する知識 ・低誘電材料に関する知識 [スキル] ・絶縁材料の設計スキル ・材料の配合、混練スキル ・材料の物性評価スキル ・顧客対応スキル

会社説明

電気部品・電子部品・制御機器・電子材料等の開発・製造・販売